#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業



6 月 2 0 日現在 令和 元年

機関番号: 13501		
研究種目: 研究活動スタート支援		
研究期間: 2017 ~ 2018		
課題番号: 17日06721		
研究課題名(和文)巨大圧電性希土類AIN膜の配向制御と次世代高周波弾性表面波フィルタへの応用		
研究细胞存(茶文)Cructalling control of your conthe depend AIN film and applications to payt		
研先課題名(英文)Crystalline control of rare earth doped AIN film and applications to next generation SAW filter with high frequency		
研究代表者		
鈴木 雅視(SUZUKI,Masashi)		
山梨大学・大学院総合研究部・特任助教		
研究者番号:60763852		
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,300,000円		

研究成果の概要(和文):本研究では次世代移動体通信用周波数フィルタ応用に向け,希土類ScAIN膜の配向性 制御とScAIN膜/LiNb03圧電基板からなる縦型漏洩弾性表面波(LLSAW)デバイスの開発を行った。成膜条件,イ オン照射条件を制御することでScAIN膜の結晶方位は制御可能であり,かつAIN膜を超える横波電気機械結合係数 k152が得られることを示した。ScAIN膜/LiNb03基板上LLSAW理論解析では,c軸配向ScAIN膜装荷によりLLSAW伝搬 減衰の低減が可能となることを示し,実験においてもこの低減は観測した。c軸平行ScAIN膜装荷では結合係数が 増幅し,LiNb03単体の約1.6倍となることを確認した。

#### 研究成果の学術的意義や社会的意義

研究成果の学術的意義や社会的意義 SAWデバイスは周波数フィルタとして実用化されている、今後さらなる通信の大容量化,高速化に向けて,より 高周波帯域な移動通信規格(3GHz以上)が検討されている、本課題では結晶方位を制御したScAIN膜をLiNb03基 板上に装荷した層状構造基板からなるSAWデバイスの開発を行い,高周波動作に要求される"高SAW位相速度,高 結合係数,低伝搬減衰"を満たすと示唆する成果を得た。これにより,現状のSAWデバイス構造では困難な次世 代移動体通信規格に対応可能な層状構造基板SAWデバイスの設計・開発指針を示すことができたと考えている。

研究成果の概要(英文):We investigated the crystalline orientation control of rare-earth doped ScAIN film, and the propagation characteristics of LLSAW on ScAIN/LiNb03 layered substrates for applications to frequency filters in next generation mobile communications. The crystalline orientation of ScAIN films could be controlled by adjusting film deposition and ion beam irradiation conditions. The ScAIN films have higher shear mode electromechanical coupling than that of pure AIN. In theoretical analysis of LLSAW characteristics on ScAIN/LiNb03, we demonstrated the reduction of LLSAW attenuation by loading c-axis oriented ScAIN on LiNb03. Moreover, K2 of LLSAW are enhanced in c-axis parallel ScAIN film/ LiNb03. The K2 of c-axis parallel ScAIN film/ LiNb03 is approximately 1.6 times higher than that of LiNb03 substrate.

研究分野: 圧電薄膜,弾性表面波デバイス

キーワード: AIN薄膜 配向制御 弾性表面波 SAWフィルタ

様 式 C-19、F-19-1、Ζ-19、CK-19(共通) 1.研究開始当初の背景

逆圧電効果を利用して弾性表面波を励振する SAW デバイス(図 1)は,携帯電話等の周波数フィルタと して利用され,移動体通信産業を支える極めて重要 な役割を果たしている.現在の移動通信システムの 周波数域は 2.2 GHz 以下であるが, スマートフォン 等の急速な発達に伴い,通信大容量化や高速化に向 け, 3GHz 以上を周波数帯域とした次世代移動通信 システムへの移行が検討されている.これを実現す るためには,周波数フィルタ用 SAW デバイスには 以下の両立が求められる.

- ・高い SAW 位相速度
- ・高い電気機械結合係数
- 広帯域幅 ・低い SAW 伝搬減衰 高〇値

高周波動作

図1 (a) 従来: 圧電単結晶基板単体構造 低位相速度(高周波動作不可)



(b) 本研究:結晶構造制御した圧電薄膜積層構造 高位相速度,高結合係数,低伝搬減衰が両立 結晶構造を制御した巨大圧電性薄膜



これらの要求に対し、「縦型漏洩弾性表面波伝搬モード」かつ「結晶方位・分極方向を制御した 希土類 AIN 系圧電薄膜/圧電単結晶基板構造(図1 (b) )」を利用した SAW デバイスが有力な候 補の一つだと考えている.

縦型漏洩弾性表面波(LLSAW)の特徴は速い SAW 位相速度である.他の伝搬モードより 2 倍程 度速度が大きく,高周波動作に適した伝搬モードである.しかし,弾性波を基板内部へ放射し ながら伝搬するため,非常に大きな伝搬損失をもつという欠点があり,従来構造(図 1(a))では 不適切な伝搬モードであった、そこで、研究協力者である垣尾らによって提案されたのが、圧 電単結晶基板上に基板よりも音速が速いアモルファス AIN 薄膜を装荷した LLSAW デバイスで ある.弾性波は速度の速い層に集中するという性質があり,高音速膜装荷により LLSAW での 伝搬減衰低減を達成している.しかし,装荷した薄膜がアモルファス構造であるがゆえ,圧電 性が有しないために SAW 伝搬に寄与せず,電気機械結合係数が小さいといった課題がある. これに対し,装荷する薄膜に「高い圧電性,高音速を有する結晶性薄膜を用いる」,かつ薄膜内 での SAW 伝搬に寄与する圧電性の大きさ,正負符号は結晶方位や分極方向で変化するため 「SAW 伝搬モードや伝搬方向に合わせて薄膜内の結晶方位や分極方向を制御する」ことで,初 めて高い SAW 位相速度,高い結合係数,低い伝搬減衰を両立する LLSAW デバイスが達成で きると考えた.このような背景のもと,以下の圧電薄膜に関する研究成果を得ていた. 「・強誘電体に匹敵する大きな圧電性をもつ希土類 AlN 薄膜の発見」

「・イオン照射による AlN 薄膜の結晶方位制御と分極方向制御」

# <u>2.研</u>究の目的

そこで本研究では , "高い SAW 位相速度・高い 電気機械結合係数・低い伝搬減衰"の両立を目的 とした「結晶方位,分極方向を制御した希土類 AlN 薄膜/圧電単結晶基板構造を用いた縦型漏洩 弾性表面波(LLSAW)デバイス」の実現(図2) に向け,(1)~(3)の研究を行った.

- (1) 希土類 AIN 薄膜の結晶方位制御
- (2) SAW 伝搬理論解析による最適な希土類 AIN 薄膜/圧電単結晶基板構造の決定
- (3) 希土類 AIN 薄膜/圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイス作製・評価
- 3.研究の方法

#### 希土類 AIN 薄膜の結晶方位制御 (1)



図2研究概略図

研究開始前の成果として,スパッタ AIN 成膜中の基板へのスパッタ粒子入射角度およびイ オン照射を制御することで、基板に依存せずに結晶方位・分極方向が制御できることを見出し ていた:"巨大圧電性希土類 AIN 膜"の結晶構造は AIN とほぼ同じ(ウルツ鉱構造)であるため, 同様の手法で結晶方位制御は可能だと考えた。まずは,図3に示す成膜装置の構築を行った。 通常のスパッタ成膜装置と構成はほとんど同じであるが、スパッタ粒子の入射角度、イオン照 射角度を変化させるために基板角度をお制御できるような機構をもつ。加えて,成膜中のイオ ン照射するために, ECR イオン源を真空チャンバー側面に装備した。表1に示す条件で ScAIN 成膜,極点 XRD 測定による結晶配向性評価, EPMA 測定による Sc 濃度測定を行い, ScAIN 薄膜においても AIN と同様に結晶配向制御が可能であるか調査を行った。また ScAIN 膜薄膜共 振子を作製し,ネットワークアナアナライザによる変換損失測定からすべりモード電気機械結 合係数を算出し,Sc濃度およびc軸傾斜角度に対する依存性について評価した。



図 3 本課題で構築したイオンビームアシスト RF マグネトロンスパッタ装置 表 1 成膜条件

基板	AI / SiO <sub>2</sub>
成膜ガス圧(N <sub>2</sub> :Ar)	0.4 Pa (1:2)
RF電力	140-200 W
成膜時間	4 -5 h
Sc粒量	1.76 - 2.3 g
基板傾斜角度α	0 ° - 90 °
膜厚	2.2 ~ 5.1 μm

## (2) SAW 伝搬理論解析による最適な ScAIN 薄膜/LiNbO3 圧電単結晶基板構造の決定

高い SAW 位相速度・高い電気機械結合係数・低い伝搬減衰を両立する SAW デバイスには, 「LLSAW 伝搬モード」,「結晶方位・分極方向を制御した巨大圧電性薄膜の圧電単結晶基板上 への装荷」が必要になると考えた.そこで,Farnell と Adler の SAW 伝搬解析法を LLSAW に拡 張した方法を用い,装荷する ScAIN 薄膜の Sc 濃度,結晶方位,分極方向,膜厚といったパラ メータを変化させた時の LLSAW 位相速度,結合係数,伝搬減衰を計算し,得られた計算結果 から LLSAW デバイスに最適な ScAIN 薄膜/圧電単結晶基板(LiNbO3)構造を決定した.

# (3) 希土類 AIN 薄膜/圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイス作製・評価

c 軸配向 ScAIN 薄膜/IDT/LiNbO3 圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイスの作製を行った。ScAIN 膜は(1)で高配向膜の得られた条件(表1)で IDT/LiNbO3 基板上に装荷した。ネットワークア ナライザを用いた周波数特性評価から薄膜を装荷しない従来 SAW デバイスの特性,および(2) で計算した理論解析結果と比較することで,作製した LLSAW デバイスの優位性,問題点を検 討した。

# 4.研究成果

## (1) 希土類 AIN 薄膜の結晶方位制御

まずは,スパッタ粒子入射角度 を 20~90°とし,結 晶方位(c 軸傾斜角度)制御した ScAIN 膜を形成し, イオ ンビームなしで成膜可能なc軸傾斜角度の調査を行った。 図 4 に各試料での(0002)極点図を示す。基板台傾斜角度 の増加に伴い薄膜内の c 軸傾斜角度も増加しているこ とがわかる。また,基板台傾斜角度を 60°とすると, c 軸の傾斜角は 50°弱となった。基板台傾斜角度を 90° とした時は,面内,面外とも結晶配向性が著しく低下し た。これは、スパッタ粒子の入射角度が基板に平行にな ったことで堆積しにくい,かつ,自己陰影効果による膜 のポーラス化が発生したためと考えられる。このことか ら、基板台の傾斜のみで作製できる c 軸傾斜膜は 50°程 度までということがわかった。次に,低加速電圧 300V で加速したイオンビームを成膜中に照射した ScAIN 膜の 形成も行った。(0002)極点図から配向性評価を行ったと ころ,低加速度イオンビーム照射ではc軸傾斜角度はほ とんど変化せず,イオン照射による ScAIN 膜での c 軸傾



斜角度制御は実現できなかった。これは,装置不良によりイオン加速電圧 300V までに制限され,AIN で c 軸角度制御に成功した高加速度ビーム(数 1000V)が照射できなかったことが主な 要因であると考えられる。

図 5 に本研究で作製した ScAIN 膜の電気機械結合係数  $k_{15}^2$ の c 軸傾斜角度依存性を示す。実曲線は AIN, ScAIN の材料定数を用いて計算した単結晶の理論曲線である。高濃度 Sc ドープ (Sc:35%付近) 試料では, AIN 単結晶を超える  $k_{15}^2$ 値が得られており, Sc ドープによる  $k_{15}^2$ 値の 増幅を確認した。c 軸傾斜角度に注目すると,理論計算通り c 軸傾斜角度 35-40 °の間で  $k_{15}^2$ 値は最大となり, c 軸傾斜角度 40 °かつ Sc 濃度 31%の薄膜で  $k_{15}^2$ = 9.9%となった. 一方でイオンビーム照射した ScAIN 薄膜では,同じ c 軸傾斜角度をもつイオンビーム照射なし試料と比較すると,  $k_{15}^2$ 値が約 2 倍程度に増幅するサンプルもあり, イオンビーム照射による ScAIN 薄膜のさらなる圧電性改善の可能性を示した。この要因としては,イオン照射による窒化の促進,結晶歪み,膜の緻密化が挙げられるが, Sc 濃度や c 軸傾斜角度,イオンビーム照射の強度,イオンビームの導入角度など未だ検討されていない部分は多くあり,今後の研究でさらなる調査 を行う。



図 5 作製した ScAIN 膜の電気機械結合係数 k<sub>15</sub><sup>2</sup>の c 軸傾斜角度依存性

### (2) SAW 伝搬理論解析による最適な ScAIN 薄膜/LiNbO3 圧電単結晶基板構造の決定

図 6 に c 軸配向もしくは c 軸平行 ScAIN 膜/X カット 36 ° Y 伝搬 LiNbO3 基板上を伝搬する LLSAW 位相速度, 伝搬減衰, 結合係数の理論解析結果を示す。c 軸配向 ScAIN 膜装荷時の位 相速度は h/ $\lambda$  <0.04 では増加し, h/ $\lambda$  0.04 で最大値(約 7700m/s)となる。h/ $\lambda$  <0.04 では減少に 転じ,約 7350m/s に収束する。伝搬減衰は, h/ $\lambda$  >0.1 でゼロ減衰となる。一方, c 軸平行 ScAIN 膜装荷の場合は,位相速度は h/ $\lambda$  <0.1 で減少し, h/ $\lambda$  0.04 で最小値(約 6600m/s)となる。h/ $\lambda$  >0.1 では増加する。また伝搬減衰は h/ $\lambda$ 增加に伴い増加することが分かった。結合係数は c 軸平行 ScAIN 薄膜装荷時に 36Y 伝搬 Xcut LiNhO3 単体より大きな値が得られ, h/ =0.1 の時最大とな り K<sup>2</sup>=21% となった。この値は LN 単体の約 1.6 倍となった。以上より, LLSAW 伝搬減衰を抑 制するためには c 軸配向 ScAIN 膜装荷,結合係数増幅には, c 軸平行 ScAIN 膜装荷が有効であることが分かった。



図 6 ScAIN 膜/LiNbO3 基板上での LLSAW 位相速度, 伝搬減衰, 結合係数の ScAIN 膜厚依存性の数値計算結果

次に, ScAIN 薄膜の c 軸傾斜角度が LLSAW の特性に及ぼす影響を評価するために,(0 0 90)ScAIN 膜の0 角度を変化させた時の LLSAW 伝搬特性を理論解析した。図 7(a),(b)に開放 状態および境界短絡状態の伝搬減衰,(c)に結合係数を示す。 $0 < h/\lambda < 0.15$ では0角度が大きくな るにつれて,結合係数が大きくなることが確認できた。一方で,結合係数が LN 単体より大き くなる 角度 80 度以上では,ゼロ減衰が得られていないため,ScAIN/LiNbO3 基板構造では結 合係数増幅とゼロ伝搬減衰の両立を実現する 角度と規格化膜厚を発見することができなかっ た。今後は,他材料基板(水晶,サファイア,LiTaO3等)を用いた場合での解析を行い,最適構 造のさらなる探索を行う予定である。



図 7 ScAIN 膜/LiNbO3 基板上での LLSAW 伝搬減衰,結合係数の ScAIN 膜 c 軸傾斜角度依存性の数値計算結果

## (3) c軸配向 AIN 薄膜/圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイス作製・評価

図 8 に作製した IDT/X カット 36Y 伝搬 LiNbO3 基板および c 軸配向 ScAIN/IDT/X カット 36Y 伝 搬 LiNbO3 基板構造を持つ LLSAW デバイスでの 挿入損失最小値の伝搬距離 L 依存性を示す。す べての L で ScAIN 膜を装荷により LLSAW の挿 入損失が改善している。また伝搬損失を各曲線 から算出すると、装荷なしでは 0.20-0.25 dB/ と 大きいが,装荷ありでは0.08-0.10 dB/となり, (2)理論解析で示された c 軸配向 ScAIN 膜装荷に よる伝搬損失の低減は観測できた。しかし,理 論解析のようなゼロ伝搬減衰は観測されなかっ た。この要因を ScAIN 表面形状と考察し, AFM により表面粗さ測定を行った。ScAIN 膜表面粗 さ Rq は 2.7nm であり, LLSAW の波長(4.8µm)よ り十分に小さかったため, ScAIN 表面形状はゼ ロ伝搬減衰が得られなかった要因とは考えづら い。現在は ScAIN と LiNbO3 の界面に存在する 結晶構造の不連続性,不活性層が原因だと考え ているおり、今後は断面 SEM 評価などを行い、 原因の解明を行う予定である。



<u>5.主な発表論文等</u>

〔雑誌論文〕(計3件)

- [1] <u>鈴木雅視</u>, 早川竜盛, 垣尾省司, "RF マグネトロンスパッタ法で形成した Cr 添加 AIN 膜の圧電特性,"電気学会研究会資料・電気回路研究会, 2018/12/07 (査読なし)
- [2] <u>Masashi Suzuki</u> and Shoji Kakio, "Theoretical analysis and design of longitudinal leaky SAW device consisting of ScAlN film / piezoelectric single crystal," Proceedings 2018 IEEE Ultrasonics symposium, 2018/10/22 (査読あり)
- [3] <u>Masashi Suzuki</u>, Masashi Gomi, and Shoji Kakio, "Propagation characteristics of longitudinal-type leaky surface acoustic wave on layered structure consisting of ScxAl1-xN film / LiNbO3 substrate," JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 57/7S1, 07LD06-1-07LD06-7 2018/04/27. (査読あり)

〔学会発表〕(計9件)

- [1] **鈴木雅視**, 垣尾省司, "ScAIN 薄膜/水晶基板上縦型リーキーSAW の伝搬減衰に速い横波, 遅い横波成分が及ぼす影響の理論的検討,"第 66 回応用物理学会春季学術講演会, 2019/03/09.
- [2] <u>鈴木雅視</u>, 早川竜盛, 垣尾省司, "RF マグネトロンスパッタ法で形成した Cr 添加 AIN 膜の圧電特性,"電子回路研究会 ・テーマ「圧電材料・デバイスと応用」, 2018/12/07.

- [3] <u>Masashi Suzuki</u>, Naoya Sawada, and Shoji Kakio, "Theoretical analysis of longitudinal wave leaky SAW propagation characteristics on ScAlN film/Quartz or Sapphire substrate," The 39th Symposium on Ultrasonic Electronics, 2018/10/29.
- [4] <u>Masashi Suzuki</u> and Shoji Kakio, "Theoretical analysis and design of longitudinal leaky SAW device consisting of ScAlN film / piezoelectric single crystal," 2018 IEEE International Ultrasonics Symposium, 2018/10/24.
- [5] **鈴木雅視**, 早川竜盛, 垣尾省司, "スパッタ成膜法による c 軸配向 CrAIN 薄膜の形成と電 気機械結合係数 kt2 評価," 第 79 回応用物理学会秋季講演会, 2018/09/18.
- [6] 鈴木雅視, 垣尾省司, "ScAIN 薄膜/水晶基板上を伝搬する縦型リーキーSAW に水晶カット 角と SAW 伝搬方向が及ぼす影響,"第 79 回応用物理学会秋季講演会, 2018/09/18.
- [7] 澤田直弥, <u>鈴木雅視</u>, 垣尾省司, "ScAIN 薄膜/水晶基板またはサファイア基板構造における縦型リーキーSAW 伝搬特性の理論解析,"第65回応用物理学会春季学術講演会, 2018/03/19.
- [8] <u>Masashi Suzuki</u> and Shoji Kakio, "Theoretical Analysis of Longitudinal-type Leaky Surface Acoustic Wave on LiNbO3 with Oriented ScAlN Film," The 38th symposium on Ultrasonic Electronics, 2017/10/25.
- [9] 鈴木雅視, 垣尾省司, "ScAIN 薄膜/LiNbO3 板構造における縦型リーキ SAW 伝搬特性の理論解析,"第 78 回応用物理学会秋季講演会, 2017/09/05.

〔図書〕なし

〔産業財産権〕なし

〔その他〕

山梨大学 研究者データベース http://nerdb-re.yamanashi.ac.jp/Profiles/338/0033743/profile.html

<u>6.研究組織</u> (1)研究分担者 なし

(2)研究協力者 研究協力者氏名:垣尾 省司 ローマ字氏名:KAKIO Shoji

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。